

证券代码：920012

证券简称：创达新材

公告编号：2026-062

无锡创达新材料股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

为进一步落实无锡创达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及业务发展、扩展产能的需要，公司购买厂区东侧新地块，用于“年产2128吨及40000平方米半导体先进封装材料生产线建设项目”（以政府部门核定的名称为准），计划投资金额人民币约11000万元。

具体内容详见公司于2026年4月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司拟对外投资暨签订工业用地投资发展监管协议的公告》（公告编号：2026-050）。

2026年4月24日，公司与江苏省无锡市自然资源和规划局签订了《国有建设用地交地确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》，取得位于新吴区运泾路北侧、创达电子东侧，编号为320214001218GB00090的国有建设用地使用权，用于项目建设。合同总金额为人民币1,360,000.00元。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司购买土地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2026-052）。

二、进展情况

近日，公司已办理完成项目的备案登记事宜。公司收到无锡高新区（新吴区）数据局颁发的《江苏省投资项目备案证》（锡新数投备〔2026〕586号），确认项目名称为“年产3678吨半导体先进封装材料生产线建设项目”。

《工业用地投资发展监管协议》签订后，公司综合考虑市场需求、公司经营需求及未来整体战略发展规划等因素，根据实际建设情况调整产能规划安排为3678吨半导体先进封装材料。项目名称以《江苏省投资项目备案证》核定为准。

三、对公司的影响

本次项目备案基于公司的经营需求，也符合公司未来整体战略发展规划，从长期发展来看，对公司的财务状况和经营成果具有积极作用。

四、风险提示

本项目尚需通过政府相关部门的环境影响评价批复、建设工程规划许可等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

本次投资项目系公司基于战略发展需要及对行业市场前景的研判所作出的决策，由于宏观环境、行业政策、市场与技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。公司将进一步强化投后管理工作，持续关注投资项目的经营状况及管理成果，积极防范、应对和控制上述风险。

五、备查文件

（一）《江苏省投资项目备案证》（锡新数投备〔2026〕586号）

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2026年6月25日